

PERSONAL LASER

Laser System



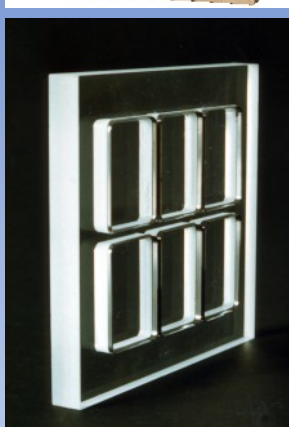
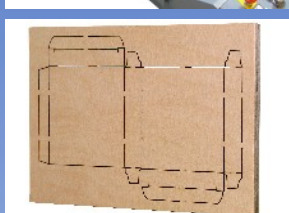
PERSONAL LASER - CO₂



LA TECNOLOGIA LASER ITALIANA NEL MONDO

COMPANY
WITH QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001 : 2000 =

PERSONAL LASER



SEI S.p.A. Si riserva di modificare i dati tecnici e le foto senza nessun preavviso.

Personal Laser (PL): è un sistema laser compatto e flessibile progettato per tagliare materiali in lastra e per soddisfare le esigenze di diversi settori industriali (taglio fustelle, legno, e acrilico).

Diverse opzioni disponibili sia per l'area di lavoro che per le potenze laser permettono al cliente di progettare un sistema secondo le sue esigenze personali.

Il sistema fornisce qualità di taglio eccellenti su tutta l'area di lavoro, ulteriori caratteristiche del sistema sono la stabilità e l'elevata precisione data dal sistema di controllo di ultima generazione.

La sorgente sigillata non necessita di manutenzione e il percorso del fascio laser ha solo uno specchio che dà luogo ad un allineamento molto semplice.

Personal laser (PL) è un sistema unico che è stato ora accettato come standard industriale e come prima scelta per molti fustellifici alla ricerca di un sistema professionale che fornisca un eccellente valore monetario. Il sistema di controllo del PC si basa su Windows e sul software ICARO che accetta DXF, HPGL, CFF2 e DDS files.

Le principali caratteristiche sono:

- Tecnologia laser sigillata CO₂ raffreddata ad acqua
- Dimensioni compatte rispetto all'area di lavoro
- Asse Z programmabile con sistema d'inseguimento superficie
- Sistema di abbattimento fumi
- Piano di lavoro con diversi supporti
- Software interpolato basato su Sp-lines cubiche
- Velocità ed accelerazione programmabili
- Testa di taglio intercambiabile.
- Controllo di motor strain sui motori X, Y, Z
- Interfaccia di facile apprendimento

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modelli	1520	1531	2031
Area di lavoro:	1550x2000	1550x3100	2000x3000 mm
Supporto lavoro:	1650x2450	1650x3640	2100x3640 mm
Passaggio luce:	1840	2020	2020 mm
Dimensioni WL*H:	3070x3720*x2100	3070x4920*x2100	3570x4920*x2100mm
Peso:	+2200	+2600	+3000 KG
Passaggio ponte:		100 mm	
Altezza piano di lavoro:		770 + 830 mm	
Capacità di carico:		80 Kg/m ² .	
Corsa asse e regolazione altezza:		450 mm	
Potenza sorgente sigillata:		115W + 2000 W	
Testa di taglio:	3,75" / 5" / 7,5" / 10"		
Velocità di lavoro assi X-Y:	500 mm/s max.		
Massima velocità di spostamento X-Y:	500 mm/s max		
Accelerazione:	4 mt./s ²		
Risoluzione X-Y-Z:	0,005 mm		
Precisione:	+/- 0,05 mm su tutta l'area		
Ripetibilità:	+/- 0,02 mm		
Planarità:	+/- 0,1 mm		
Controllo:	Microprocessor Pentium 4 2,4 GHz, TFT 12" LCD, 256Mb RAM, Floppy-Disk, CD Rom, tastiera, Trackball, Windows XP PRO, SW CAM ICARO		
Interfaccia:	N°1 porta parallela, n°1 porta seriale Rs232, N°1 USB port, n°1 Ethernet LAN 10/100 Mbit/s, MODEM opzionale.		
Alimentazione:	380V +/- 10% (3ph+g+n) 50 Hz 11 KW + 70 KW		
Consumo aria compressa:	100 nl/min. 6+8 bar (filtrato da olio)		
Temperatura operativa:	10+40° C		
Umidità relativa:	10+85% RH max senza condensa		
temperatura di stoccaggio:	-10+70° C (circuito H ₂ O vuoto)		

*In fase operativa: "L" + 250 mm

ATTENZIONE !!
 RADIAZIONE LASER INVISIBILE
 EVITARE L'ESPOSIZIONE DELL'OCCHIO E DELLA PELLE ALLA RADIAZIONE DIRETTA O DIFFUSA.
 APPARECCHIO LASER CLASSE 4

SEI S.p.A.
 Via Ruffilli, 1 24035 Curno (BG) Italy tel. ++39 0354376016
 fax ++39 035463843 <http://www.seilaser.com> e-mail: info@seilaser.com